

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號： 1347

## 新聞稿

# 華虹半導體二零一九年第二季度業績公佈

*所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。*

*本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。*

中國香港 — 2019年8月6日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一九年六月三十日止三個月的綜合經營業績。

### 二零一九年第二季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入 2.3 億美元，同比持平，環比增長 4.2%。
- 毛利率 31.0%，同比下降 2.6 個百分點，環比下降 1.2 個百分點。
- 期內溢利 4,990 萬美元，同比上升 8.7%，環比上升 7.0%。
- 基本每股盈利 0.034 美元，同比下降 0.01 美元，環比下降 0.003 美元。
- 淨資產收益率（年化）8.0%。

### 二零一九年第三季度指引

- 我們預計銷售收入約 2.38 億美元左右。
- 我們預計毛利率約 31% 左右。

## 總裁致辭

本公司總裁兼執行董事唐均君先生，對第二季度的業績評論道：

“儘管全球半導體市場持續放緩，華虹半導體不斷銳意進取，致力於成為更強、更優的企業。我們第二季度的銷售收入為 2.3 億美元，同比持平，環比增長 4.2%。以下是一些亮點：分立器件平臺繼續顯示出巨大的優勢，各產品的需求都在增加，尤其是超級結、IGBT 和通用 MOSFET。我們預計分立器件在未來的需求仍將持續增長。此外，得益於中國、北美和其他亞洲國家市場的強勁表現，來自模擬與電源管理平臺的銷售收入，環比增長近 41%。第二季度毛利率 31%，同比下降 2.6 個百分點；環比下降 1.2 個百分點，主要由於折舊成本上升，但部分被產能利用率的提升所抵消。淨利潤率達到可觀的 21.7%，同比上升 1.7 個百分點，環比上升 0.6 個百分點。”

“正如我在上一季度業績公告中所說，對半導體行業我們仍然保持樂觀。儘管同時面臨來自市場、技術、客戶以及即將投入使用的新 12 英寸晶圓廠等諸多挑戰，但我們的傾力付出得到了回報。通過團隊的不懈努力和客戶的鼎力支持，我們的整體產能利用率已經回升到了 90% 以上。我們非常有信心 2019 年下半年的表現將比上半年更為強勁。”

“300mm 晶圓項目正按計劃平穩推進，廠房和潔淨室已經完成建設。同時，第一批 1 萬片產能所需的大部分機器設備已經搬入，目前正處於安裝和測試階段。無錫工廠將於 2019 年第四季度開始試生產 300mm 晶圓。我們的工程師團隊和客戶正密切合作開發幾個新產品，為初期爬坡試生產作準備。我們滿懷期待地迎接這個時刻的到來。”

## 電話會議公告

日期： 二零一九年八月七日（星期三）

時間： 下午 04:00（上海 / 香港）  
上午 04:00（紐約，2019 年 8 月 7 日，星期三）

發言人： 唐均君，總裁兼執行董事  
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

[http://www.huahonggrace.com/html/investor\\_webcast.php](http://www.huahonggrace.com/html/investor_webcast.php) 或

[https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~2q\\_2019\\_earnings\\_call](https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~2q_2019_earnings_call)

電話詳細：

国际	+65 6713 5521
中國	+86 800 870 0531/+86 400 624 0406
香港	+852 3018 6768
臺灣	+886 277 031 751
紐約	+1 347 549 4095

電話會議登入名： 9755089

密碼： HUAHONG

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 [http://www.huahonggrace.com/s/investor\\_webcast.php](http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php) 網頁上，重複收聽會議。（回放密碼：Huahong）

## 關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（“本公司”）是全球領先的純晶圓代工企業，特別專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯及射頻等差異化特色工藝平臺，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是國家“909”工程的載體，是以集成電路製造為主業、面向全球市場、具有自主創新能力和市場競爭力的高科技產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 200mm 晶圓廠（華虹一廠、二廠、及三廠），月產能約 17.5 萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內新建一條月產能 4 萬片的 300mm 集成電路生產線（華虹七廠）。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>。

**經營業績概要**  
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零一九年 第二季度 (未經審核)	二零一八年 第二季度 (未經審核)	二零一九年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	230,037	229,868	220,753	0.1 %	4.2 %
銷售成本	(158,614)	(152,622)	(149,756)	3.9 %	5.9 %
<b>毛利</b>	<b>71,423</b>	<b>77,246</b>	<b>70,997</b>	<b>(7.5)%</b>	<b>0.6 %</b>
<b>毛利率</b>	<b>31.0 %</b>	<b>33.6 %</b>	<b>32.2 %</b>	<b>(2.6)</b>	<b>(1.2)</b>
經營開支	(35,352)	(34,030)	(31,727)	3.9 %	11.4 %
其他收入淨額	24,616	16,082	5,457	53.1 %	351.1 %
<b>稅前溢利</b>	<b>60,687</b>	<b>59,298</b>	<b>44,727</b>	<b>2.3 %</b>	<b>35.7 %</b>
所得稅(開支)/收益	(10,793)	(13,401)	1,914	(19.5)%	(663.9)%
<b>期內溢利</b>	<b>49,894</b>	<b>45,897</b>	<b>46,641</b>	<b>8.7 %</b>	<b>7.0 %</b>
<b>淨利潤率</b>	<b>21.7 %</b>	<b>20.0 %</b>	<b>21.1 %</b>	<b>1.7</b>	<b>0.6</b>
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	43,360	45,791	47,466	(5.3)%	(8.7)%
非控股權益	6,534	106	(825)	6,064.2 %	(892.0)%
持有人應佔每股盈利					
基本	0.034	0.044	0.037	(22.7)%	(8.1)%
攤薄	0.033	0.043	0.037	(23.3)%	(10.8)%
付運晶圓(仟片)	489	501	446	(2.4)%	9.6 %
產能利用率 <sup>1</sup>	93.2 %	101.5 %	87.3 %	(8.3)	5.9
淨資產收益率 <sup>2</sup>	8.0 %	10.4 %	8.8 %	(2.4)	(0.8)

**二零一九年第二季度**

- 銷售收入 2.3 億美元，同比持平，環比增長 4.2%。
- 銷售成本 1.586 億美元，同比上升 3.9%，主要由於折舊成本及原材料單位成本上升；環比上升 5.9%，主要由於晶圓銷售量上升。
- 毛利率 31.0%，同比下降 2.6 個百分點，主要由於產能利用率降低和折舊成本上升；環比下降 1.2 個百分點，主要由於折舊成本上升及產品組合變化，部分被產能利用率的提升所抵消。
- 經營開支 3,540 萬美元，同比上升 3.9%，主要由於人工費用上升，部分被上年同期計提設備減值準備所抵消；環比上升 11.4%，主要由於人工費用上升。
- 其他收入淨額 2,460 萬美元，同比上升 53.1%，主要受益於以下收益的增加(i)匯兌收益，(ii)以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益，及(iii)利息收入，部分被分佔一家聯營公司溢利減少所抵消；環比上升 351.1%，主要由於(i)本季度取得匯兌收益，上季度為匯兌損失，及(ii)以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益增加。
- 所得稅開支 1,080 萬美元，同比下降 19.5%，主要由於應課稅利潤減少。
- 期內溢利 4,990 萬美元，同比上升 8.7%，環比上升 7.0%。
- 淨利潤率 21.7%，同比上升 1.7 個百分點，環比上升 0.6 個百分點。
- 基本每股盈利 0.034 美元，同比下降 0.01 美元，環比下降 0.003 美元。
- 淨資產收益率(年化) 8.0%。

<sup>1</sup>產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

<sup>2</sup>母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零一九年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第二季度 % (未經審核)	二零一八年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	225,012	97.8 %	225,196	98.0 %	(184)	(0.1)%
其他	5,025	2.2 %	4,672	2.0 %	353	7.6 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>230,037</b>	<b>100.0 %</b>	<b>229,868</b>	<b>100.0 %</b>	<b>169</b>	<b>0.1 %</b>

- 本季度 97.8% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零一九年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第二季度 % (未經審核)	二零一八年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 <sup>3</sup>	127,335	55.4 %	134,502	58.6 %	(7,167)	(5.3)%
美國	42,042	18.3 %	39,805	17.3 %	2,237	5.6 %
亞洲 <sup>4</sup>	28,041	12.2 %	29,032	12.6 %	(991)	(3.4)%
歐洲	18,246	7.9 %	16,542	7.2 %	1,704	10.3 %
日本 <sup>5</sup>	14,373	6.2 %	9,987	4.3 %	4,386	43.9 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>230,037</b>	<b>100.0 %</b>	<b>229,868</b>	<b>100.0 %</b>	<b>169</b>	<b>0.1 %</b>

- 本季度來自於中國的銷售收入 1.273 億美元，占銷售收入總額的 55.4%，同比減少 5.3%，主要由於智能卡芯片的需求減少，部分被超級結產品的需求增加所抵消。
- 本季度來自於美國的銷售收入 4,200 萬美元，同比增長 5.6%，主要得益於通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 2,800 萬美元，同比減少 3.4%，主要由於 MCU 和邏輯產品的需求減少，部分被超級結和通用 MOSFET 產品的需求增加所抵消。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 1,820 萬美元，同比增長 10.3%，主要得益於通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度來自於日本的銷售收入 1,440 萬美元，同比增長 43.9%，主要得益於 MCU 和邏輯產品的需求增加。

<sup>3</sup>包括香港。

<sup>4</sup>不包括中國及日本。

<sup>5</sup>包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

### 銷售收入分析

按技術平臺劃分的 銷售收入	二零一九年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第二季度 % (未經審核)	二零一八年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	79,583	34.6 %	88,608	38.6 %	(9,025)	(10.2)%
分立器件	92,487	40.2 %	75,988	33.1 %	16,499	21.7 %
模擬與電源管理	33,371	14.5 %	37,504	16.3 %	(4,133)	(11.0)%
邏輯及射頻	21,606	9.4 %	21,646	9.4 %	(40)	(0.2)%
獨立非易失性存儲器	2,709	1.2 %	6,027	2.6 %	(3,318)	(55.1)%
其他	281	0.1 %	95	-	186	195.8 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>230,037</b>	<b>100.0 %</b>	<b>229,868</b>	<b>100.0 %</b>	<b>169</b>	<b>0.1 %</b>

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 7,960 萬美元，同比減少 10.2%，主要由於智能卡芯片的需求減少，部分被 MCU 產品的需求增加所抵消。
- 本季度分立器件銷售收入 9,250 萬美元，同比增長 21.7%，主要得益於超級結和通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 3,340 萬美元，同比減少 11.0%，主要由於 LED 照明、其他電源管理和模擬產品的需求減少。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 2,160 萬美元，同比持平。
- 本季度獨立非易失性存儲器銷售收入 270 萬美元，同比減少 55.1%，主要由於閃存和 EEPROM 產品的需求減少。

### 銷售收入分析

按工藝技術節點 劃分的銷售收入	二零一九年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第二季度 % (未經審核)	二零一八年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
0.13 $\mu$ m 及以下	73,783	32.1 %	83,383	36.3 %	(9,600)	(11.5)%
0.15 $\mu$ m 及 0.18 $\mu$ m	25,155	10.9 %	31,108	13.5 %	(5,953)	(19.1)%
0.25 $\mu$ m	2,133	0.9 %	3,697	1.6 %	(1,564)	(42.3)%
0.35 $\mu$ m 及以上	128,966	56.1 %	111,680	48.6 %	17,286	15.5 %
<b>銷售收入總額</b>	<b>230,037</b>	<b>100.0 %</b>	<b>229,868</b>	<b>100.0 %</b>	<b>169</b>	<b>0.1 %</b>

- 本季度 0.13 $\mu$ m 及以下工藝技術節點的銷售收入 7,380 萬美元，同比減少 11.5%，主要由於智能卡芯片的需求減少。
- 本季度 0.15 $\mu$ m 及 0.18 $\mu$ m 工藝技術節點的銷售收入 2,520 萬美元，同比減少 19.1%，主要由於 MCU 產品的需求減少。
- 本季度 0.25 $\mu$ m 工藝技術節點的銷售收入 210 萬美元，同比減少 42.3%，主要由於邏輯產品和智能卡芯片的需求減少。
- 本季度 0.35 $\mu$ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.29 億美元，同比增長 15.5%，主要得益於超級結、智能卡芯片和通用 MOSFET 產品的需求增加。

### 銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一九年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第二季度 % (未經審核)	二零一八年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
電子消費品	147,160	64.0 %	145,707	63.4 %	1,453	1.0 %
工業及汽車	44,285	19.3 %	47,323	20.6 %	(3,038)	(6.4)%
通訊	28,134	12.2 %	25,741	11.2 %	2,393	9.3 %
計算機	10,458	4.5 %	11,097	4.8 %	(639)	(5.8)%
<b>銷售收入總額</b>	<b>230,037</b>	<b>100.0 %</b>	<b>229,868</b>	<b>100.0 %</b>	<b>169</b>	<b>0.1 %</b>

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 1.472 億美元，占銷售收入總額的 64.0%，同比增長 1.0%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 4,430 萬美元，同比減少 6.4%，主要由於智能卡芯片需求的減少，部分被通用 MOSFET 產品的需求增加所抵消。
- 本季度通訊產品銷售收入 2,810 萬美元，同比增長 9.3%，主要得益於通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度計算機產品銷售收入 1,050 萬美元，同比減少 5.8%，主要由於通用 MOSFET 產品的需求減少。

### 產能<sup>6</sup>及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零一九年 第二季度 (未經審核)	二零一八年 第二季度 (未經審核)	二零一九年 第一季度 (未經審核)
1 號晶圓廠	65	65	65
2 號晶圓廠	60	59	60
3 號晶圓廠	50	48	50
<b>合計</b>	<b>175</b>	<b>172</b>	<b>175</b>
產能利用率	93.2%	101.5%	87.3%

- 本季度末月產能為 175,000 片，本季度產能利用率為 93.2%。

<sup>6</sup> 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

### 付運晶圓

仟片晶圓	二零一九年 第二季度 (未經審核)	二零一八年 第二季度 (未經審核)	二零一九年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	489	501	446	(2.4)%	9.6%

- 本季度付運晶圓 489,000 片，同比減少 2.4%，環比增加 9.6%。

### 經營開支分析

以千美元計	二零一九年 第二季度 (未經審核)	二零一八年 第二季度 (未經審核)	二零一九年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	1,979	1,963	2,025	0.8 %	(2.3)%
管理費用 <sup>7</sup>	33,373	32,067	29,702	4.1 %	12.4 %
<b>經營開支</b>	<b>35,352</b>	<b>34,030</b>	<b>31,727</b>	<b>3.9 %</b>	<b>11.4 %</b>

- 經營開支 3,540 萬美元，同比上升 3.9%，主要由於人工費用上升，部分被上年同期計提設備減值準備所抵消；環比上升 11.4%，主要由於人工費用上升。

### 其他收入淨額

以千美元計	二零一九年 第二季度 (未經審核)	二零一八年 第二季度 (未經審核)	二零一九年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,225	3,433	3,184	(6.1)%	1.3 %
利息收入	5,661	2,057	5,638	175.2 %	0.4 %
以公允價值計量且變動計入當期損益 的金融資產之公允價值變動收益	7,627	1,787	5,873	326.8 %	29.9 %
匯兌收益/(損失)	7,589	1,731	(9,691)	338.4 %	(178.3)%
分佔一家聯營公司溢利	627	4,708	383	(86.7)%	63.7 %
財務費用	(309)	(690)	(316)	(55.2)%	(2.2)%
政府補貼	82	2,726	229	(97.0)%	(64.2)%
其他	114	330	157	(65.5)%	(27.4)%
<b>其他收入淨額</b>	<b>24,616</b>	<b>16,082</b>	<b>5,457</b>	<b>53.1 %</b>	<b>351.1 %</b>

- 其他收入淨額 2,460 萬美元，同比上升 53.1%，主要受益於以下收益的增加(i)匯兌收益，(ii)以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益，及(iii)利息收入，部分被分佔一家聯營公司溢利減少所抵消；環比上升 351.1%，主要由於(i)本季度取得匯兌收益，上季度為匯兌損失，及(ii)以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益增加。

<sup>7</sup>管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。



### 現金流量分析

以千美元計	二零一九年 第二季度 (未經審核)	二零一八年 第二季度 (未經審核)	二零一九年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	20,659	51,953	78,859	(60.2)%	(73.8)%
投資活動所用現金流量淨額	(280,795)	(155,088)	(24,124)	81.1 %	1,064.0 %
融資活動所(用)/得現金流量淨額	(52,974)	333,523	317,684	(115.9)%	(116.7)%
外匯匯率變動影響淨額	(7,471)	(11,327)	5,840	(34.0)%	(277.9)%
<b>現金及現金等價物變動影響淨額</b>	<b>(320,581)</b>	<b>219,061</b>	<b>378,259</b>	<b>(246.3)%</b>	<b>(184.8)%</b>

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 2,070 萬美元，同比下降 60.2%，主要由於待抵扣增值稅進項稅額的支付增加。
- 投資活動所用現金流量淨額 2.808 億美元，其中包括(i)設備投資支出 2.231 億美元，及(ii)以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產投資支出 6,320 萬美元，部分被收到利息收入 550 萬美元所抵消。
- 融資活動所用現金流量淨額 5,300 萬美元，其中包括(i)支付股息 5,100 萬美元，(ii)償還銀行貸款本金 220 萬美元，(iii)租賃負債支出 20 萬美元，及(iv)支付利息 10 萬美元，部分被發行股份收到的投資款 50 萬美元所抵消。

### 資本結構

以千美元計	於六月三十日 二零一九年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一九年 (未經審核)
資產總額	3,544,900	3,521,393
負債總額	485,546	400,317
所有者權益總額	3,059,354	3,121,076
資產負債率 <sup>8</sup>	13.7%	11.4%

### 資本開支

以千美元計	二零一九年 第二季度 (未經審核)	二零一九年 第一季度 (未經審核)
華虹宏力	40,692	25,322
華虹無錫	182,361	84,895
<b>合計</b>	<b>223,053</b>	<b>110,217</b>

- 本季度資本開支 2.231 億美元，其中 1.824 億美元用於華虹無錫。

<sup>8</sup> 資產負債率=負債總額/資產總額。

## 流動性分析

以千美元計	於六月三十日 二零一九年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一九年 (未經審核)
存貨	139,128	140,322
貿易應收款項及應收票據	147,771	160,012
預付款項、按金及其他應收款項	72,067	20,360
應收關聯方款項	4,366	6,789
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	658,306	606,094
已凍結存款及定期存款	14,724	796
現金及現金等價物	834,678	1,155,259
<b>流動資產總額</b>	<b>1,871,040</b>	<b>2,089,632</b>
貿易應付款項	76,966	74,880
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	267,047	151,363
計息銀行借款	4,364	4,455
租賃負債	1,381	1,393
政府補助	55,335	59,810
應付關聯方款項	12,688	17,697
應付所得稅	18,908	37,699
<b>流動負債總額</b>	<b>436,689</b>	<b>347,297</b>
<b>淨營運資金</b>	<b>1,434,351</b>	<b>1,742,335</b>
速動比率	4.0x	5.6x
流動比率	4.3x	6.0x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	61	69
存貨周轉天數	79	81

- 預付款項、按金及其他應收款項由上季度末的 2,040 萬美元上升至本季度末的 7,210 萬美元，主要由於對供應商的預付款及待抵扣進項稅的增加。
- 應收關聯方款項由上季度末的 680 萬美元下降至本季度末的 440 萬美元，主要由於來自一些關聯方的貿易應收款項減少。
- 已凍結存款及定期存款由上季度末的 80 萬美元上升至本季度末的 1,470 萬美元，主要由於本季末部分未兌付股息的凍結存款增加 1,390 萬美元。
- 其他應付款項、預收賬款及暫估費用由上季度末的 1.514 億美元上升至本季度末的 2.67 億美元，主要由於(i)應付資本開支增加，及(ii)本季末未兌付股息增加。
- 應付關聯方款項由上季度末的 1,770 萬美元下降至本季度末的 1,270 萬美元，主要由於確認了本季度的關聯方房屋租金。
- 應付所得稅由上季度末的 3,770 萬美元下降至本季度末的 1,890 萬美元，主要由於支付 2018 年度所得稅。
- 本季度末淨營運資金 14.344 億美元，流動比率 4.3。
- 本季度末貿易應收款項及應收票據周轉天數 61 天。
- 本季度末存貨周轉天數 79 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 [www.huahonggrace.com](http://www.huahonggrace.com)。

華虹半導體有限公司  
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於六月三十日 二零一九年 (未經審核)	於六月三十日 二零一八年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一九年 (未經審核)
銷售收入	230,037	229,868	220,753
銷售成本	(158,614)	(152,622)	(149,756)
<b>毛利</b>	<b>71,423</b>	<b>77,246</b>	<b>70,997</b>
其他收入及收益	24,302	12,530	15,093
銷售及分銷費用	(1,979)	(1,963)	(2,025)
管理費用	(33,373)	(32,067)	(29,702)
其他費用	(4)	(466)	(9,703)
財務費用	(309)	(690)	(316)
分佔一家聯營公司溢利	627	4,708	383
<b>稅前溢利</b>	<b>60,687</b>	<b>59,298</b>	<b>44,727</b>
所得稅(開支)/收益	(10,793)	(13,401)	1,914
<b>期內溢利</b>	<b>49,894</b>	<b>45,897</b>	<b>46,641</b>
以下各方應佔利潤:			
母公司擁有人	43,360	45,791	47,466
非控股權益	6,534	106	(825)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.034	0.044	0.037
攤薄	0.033	0.043	0.037
<b>用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數</b>	<b>1,285,237,562</b>	<b>1,039,907,108</b>	<b>1,284,456,115</b>
<b>用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數</b>	<b>1,299,346,562</b>	<b>1,052,787,108</b>	<b>1,298,603,115</b>

華虹半導體有限公司  
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於六月三十日 二零一九年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一九年 (未經審核)	於六月三十日 二零一八年 (未經審核)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	1,037,724	853,827	727,636
使用權資產	16,914	17,678	-
投資物業	170,939	174,523	177,349
預付土地租賃款項	58,570	59,962	61,521
無形資產	12,198	10,087	6,693
於聯營公司的投資	64,900	65,620	61,928
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	208,008	212,370	216,177
長期預付款項	90,270	23,658	8,016
應收關聯方款項	6,908	7,053	-
遞延稅項資產	7,429	6,983	7,832
<b>非流動資產總額</b>	<b>1,673,860</b>	<b>1,431,761</b>	<b>1,267,152</b>
<b>流動資產</b>			
存貨	139,128	140,322	127,997
貿易應收款項及應收票據	147,771	160,012	121,528
預付款項、按金及其他應收款項	72,067	20,360	11,346
應收關聯方款項	4,366	6,789	51,496
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	658,306	606,094	190,134
已凍結存款及定期存款	14,724	796	64,069
現金及現金等價物	834,678	1,155,259	836,722
<b>流動資產總額</b>	<b>1,871,040</b>	<b>2,089,632</b>	<b>1,403,292</b>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	76,966	74,880	66,561
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	267,047	151,363	143,445
計息銀行借款	4,364	4,455	60,694
租賃負債	1,381	1,393	-
政府補助	55,335	59,810	42,205
應付關聯方款項	12,688	17,697	19,055
應付所得稅	18,908	37,699	18,888
<b>流動負債總額</b>	<b>436,689</b>	<b>347,297</b>	<b>350,848</b>
<b>流動資產淨額</b>	<b>1,434,351</b>	<b>1,742,335</b>	<b>1,052,444</b>
<b>總資產減流動負債</b>	<b>3,108,211</b>	<b>3,174,096</b>	<b>2,319,596</b>
<b>非流動負債</b>			
計息銀行借款	24,001	26,732	29,471
租賃負債	16,653	16,926	-
遞延稅項負債	8,203	9,362	8,855
<b>非流動負債總額</b>	<b>48,857</b>	<b>53,020</b>	<b>38,326</b>
<b>淨資產</b>	<b>3,059,354</b>	<b>3,121,076</b>	<b>2,281,270</b>
<b>權益和負債權益</b>			
股本	1,961,742	1,960,929	1,558,999
儲備	234,763	285,854	165,406
本公司擁有人應佔權益	<b>2,196,505</b>	<b>2,246,783</b>	<b>1,724,405</b>
非控股權益	862,849	874,293	556,865
<b>權益總額</b>	<b>3,059,354</b>	<b>3,121,076</b>	<b>2,281,270</b>

華虹半導體有限公司  
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於六月三十日 二零一九年 (未經審核)	於六月三十日 二零一八年 (未經審核)	於三月三十一日 二零一九年 (未經審核)
<b>經營活動所得現金流量：</b>			
稅前溢利	60,687	59,298	44,727
折舊及攤銷	32,610	29,436	30,533
應佔聯營公司溢利	(627)	(4,708)	(383)
營運資金的變動及其它	(72,011)	(32,073)	3,982
<b>經營活動所得現金流量淨額</b>	<b>20,659</b>	<b>51,953</b>	<b>78,859</b>
<b>投資活動所用現金流量：</b>			
購買物業、廠房及設備項目	(223,053)	(28,885)	(110,217)
其他投資活動所(用)/得現金流量	(57,742)	(126,203)	86,093
<b>投資活動所用現金流量</b>	<b>(280,795)</b>	<b>(155,088)</b>	<b>(24,124)</b>
<b>融資活動所(用)/得現金流量：</b>			
非控股權益資本注資	-	377,000	317,000
發行股份所得收益	537	620	779
向股東支付股息	(37,042)	(27,221)	-
已凍結存款的增加	(13,943)	(13,867)	-
償還銀行貸款	(2,182)	(2,267)	-
償還租賃負債	(249)	-	-
已付利息	(95)	(742)	(95)
<b>融資活動所(用)/得現金流量</b>	<b>(52,974)</b>	<b>333,523</b>	<b>317,684</b>
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(313,110)	230,388	372,419
外匯匯率變動影響淨額	(7,471)	(11,327)	5,840
期初現金及現金等價物	1,155,259	617,661	777,000
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>834,678</b>	<b>836,722</b>	<b>1,155,259</b>

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

**非執行董事**

杜洋

森田隆之

王靖

葉峻

**獨立非執行董事**

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

**承董事會命**

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零一九年八月六日